



TIS[®]800K 系列是一款在聚酰亚胺薄膜上涂覆陶瓷混合导热材料的导热硅胶产品，具备优异的导热性与热传导效率。TIS[®]800K可通过螺丝安装于设备开孔处，复合聚酰亚胺薄膜提供优良的耐电压绝缘性能，表面的柔软导热涂层则有效提升空隙填充能力与操作便利性。

特性

- 》表面较柔软，良好的导热率
- 》高压绝缘，低热阻
- 》抗撕裂，抗穿刺

应用

- 》电源与车用蓄电池
- 》功率半导体器件
- 》视听产品
- 》充电桩

TIS[®]800K 系列特性表

产品名称	TIS [®] 806K	TIS [®] 808K	TIS [®] 810K	测试标准
颜色	淡琥珀色			目视
聚酰亚胺膜厚度 (inch/mm)	0.001"/0.025 mm			ASTM D374
总厚度 (inch/mm)	0.006"/0.152 mm	0.008"/0.203 mm	0.010"/0.254 mm	
密度 (g/cc)	2.0			ASTM D792
抗张强度 (MPa)	10			ASTM D751
建议使用温度范围 (°C)	-45~160			兆科测试
击穿电压 (VAC)	6500	7000	7500	ASTM D149
介电常数	3.8			ASTM D150
体积电阻率 (Ohm·cm)	3.5X10 ¹³			ASTM D257
导热系数 (W/mK)	1.3			ASTM D5470
阻燃率	V-0			UL94

标准厚度: 0.006" (0.152 mm), 0.008" (0.203 mm), 0.010" (0.254 mm)

如需不同厚度请联系本公司。

标准尺寸: 10" x 100" (254 mm x 25.4 m), TIS[®]800K系列可模切成不同形状提供。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性，可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。



TIS800K-0725